

# Produktdatenblatt

hm2.0 Messerleiste Bauform C,  
Art. Nr. 243-31310-15

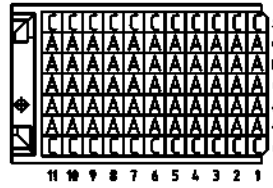


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- Polzahl 77
- Anschlusslänge 3.7 mm
- für Leiterplattendicke > 2.2 mm
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf [www.ept.de](http://www.ept.de)



» zur Produktgruppe hm 2.0

# Produktdatenblatt

hm2.0 Messerleiste Bauform C,  
Art. Nr. 243-31310-15



## Technische Daten

### Grundlagen

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Spezifikation      | IEC 61076-4-101  |
| Gütestufe          | 2                |
| Anzahl Kontakte    | 77               |
| Anschlusstechnik   | Einpresstechnik  |
| Anschlusslänge     | 3.7 mm           |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C |

### Material

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Isolierkörper                | PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0 |
| CTI Wert<br><i>IEC 60112</i> | 200                               |
| Kontaktmaterial              | Bronze                            |

### Mechanisch

|                        |  |
|------------------------|--|
| Rastermaß              | 2.0 mm   |
| Steckkraft pro Kontakt | Kontakt: max. 0.75 N, Abschirmung: max. 1 N    |
| Ziehkraft pro Kontakt  | Kontakt: min. 0.15 N, Abschirmung: min. 0.15 N |
| Lebensdauer            | > 250 Steckzyklen                              |

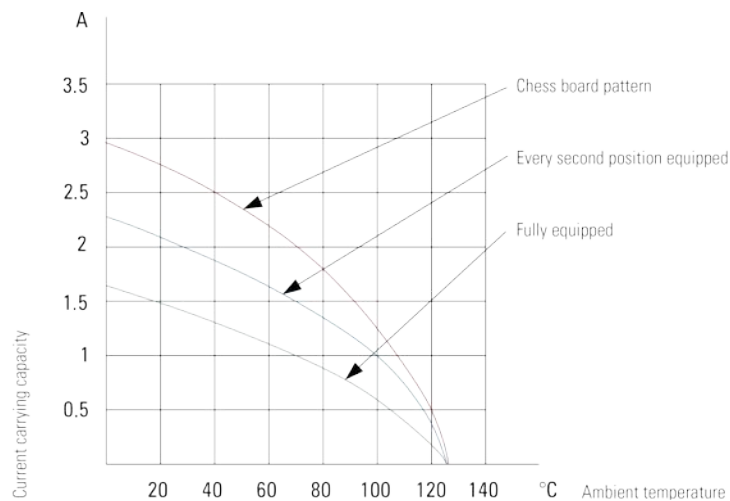
### Elektrisch

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Betriebsstrom           | 1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C |
| Durchgangswiderstand    | max. 20 mΩ                   |
| Luft- und Kriechstrecke | ≥ 0.8 mm                     |
| Isolationswiderstand    | min. 10 <sup>4</sup> MΩ      |
| Prüfspannung            | 750 V r.m.s                  |
| Datenübertragung        | 3.125 Gbit/s                 |

### Zulassungen / Konformität

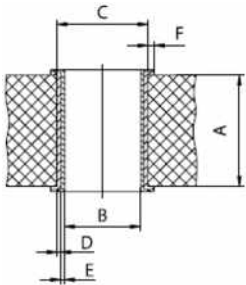
|         |              |
|---------|--------------|
| UL file | E130314      |
| Umwelt  | RoHS konform |

### Derating Diagramm



### Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



| Material                    | chem. Sn Schicht                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 0.6 mm</b>                     |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 2.2 mm                          |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 0.60 ±0.05 mm                     |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 0.70 ±0.02 mm                       |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm                          |
| <b>E Oberfläche</b>         | max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm                         |

| Material                    | Ni, Au Leiterplatten                                |
|-----------------------------|---|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 0.6 mm</b>                                     |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 2.2 mm  |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 0.60 ±0.05 mm                                     |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 0.70 ±0.02 mm                                       |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm  |
| <b>E Oberfläche</b>         | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm   |

| Material                    | rein Cu Leiterplatten                          |
|-----------------------------|--|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 0.6 mm</b>                                |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 2.2 mm                                     |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 0.60 ±0.05 mm                                |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 0.70 ±0.02 mm                                  |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm                                     |
| <b>E Oberfläche</b>         | OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm                                    |

| Material                    | HAL Sn Leiterplatten |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Nennloch</b>             | <b>Ø 0.6 mm</b>      |
| <b>A Leiterplattendicke</b> | min 2.2 mm           |
| <b>B Endloch</b>            | Ø 0.60 ±0.05 mm      |
| <b>C Grundbohrung</b>       | 0.70 ±0.02 mm        |
| <b>D Cu Schicht</b>         | min. 25 µm           |
| <b>E Oberfläche</b>         | HAL Sn, 5 - 15 µm    |
| <b>F Restring</b>           | min. 0.1 mm          |

# Produktdatenblatt

hm2.0 Messerleiste Bauform C,  
Art. Nr. 243-31310-15

---



## Varianten

für LP-Dicke 1.4 - 2.2 gilt die Artikelnummer: 243-31310-05

## Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Sonderbestückung
- Andere Kontaktbeschichtung

## Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

» [PDF](#)

» [3D IGES](#)

» [3D STEP](#)

» [3D PDF](#)